## 温度冲击试验和循环试验之比较

温度冲击试验和温度循环试验之比较各种试验目的及环境条件:

目的 加速应力试验 加速寿命试验 环境应力<u>筛</u>选试验 (ESS)

试验标准 MIL-STD-202 Method 107 IEC60749-25

JEDEC JESD22-A104-b IEC68-2-1

MIL-STD-2164-85

试验方法 温度冲击试验 温度循环试验 温度循环试验

试验环境 比使用环境更严酷 极限使用环境 极限使用环境

试样 零部件 元器件, 焊点(BGA, CSP) 成品

试样尺寸 小 小 比较大

试验温度范围 -40 (-55) ~125 (150) ℃ -40 (-65) ~125 (150) ℃ -40 (-0) ~100℃

温度变化率1槽法:大于30℃/分钟(空气)

2 槽法: 大于 50℃/分钟 (空气) 1 槽法: 小于 15℃/分钟 (试样) 1<u>槽</u>法: 小于 20℃/分钟 (空气)

加速系数 100~500 倍 比加速试验加速系数小 10~20 倍

试验结果 设计信息 设计信息 生产品质差异验证

温度冲击试验:

升温/降温速率不低于 30℃/分钟。温度变化范围很大,同时试验严<u>酷</u>度还随着温度变化率的增加而增加。

温度冲击试验与温度循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。温度冲击试验主要考察由于蠕变及疲劳损伤引起的失效,而温度循环主要考察由于剪切疲劳引起的失效。

温度冲击试验容<u>许</u>使用二槽式试验装置;温度循环试验使用单槽式试验装置。在二槽式箱体内,温度变化率要大于50℃/分钟。 中国可靠性网 http://可靠性.com

※引起温度冲击的原因:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。

※加速应力试验:加速试验是使用比在实际环境中更短的时间,对试验样品进行的加速试验,以考察其失效机理。试验的加速就是采用加大应力的方法促使试验样品在短期内失效,。但是必须注意避免其它应力原因引起的失效机理。

## 温度循环试验:

温度循环就是将试验样品曝露于予设的高低温交替的试验环境中。为避开温度冲击影响,试验时的温度变化率必须小于 20°C/分钟。同时,为达到蠕变及疲劳损伤的效果,<u>推</u>荐试验温度循环为 25°C~100°C,或者也可根据产品的用途使用 0°C~100°C的循环试验,曝露时间为各 15分钟。

环境应力筛选试验(ESS= Environmental Stress Screening):

对产品施加环境应力促使早期失效产品存在的潜在<u>缺</u>陷尽快暴露而予以剔除。**ESS**不是加速可靠性试验,主要适用于成品的可靠性筛选试